



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 18683/18684

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2023 年第三季度自结财务报告

2023 年 10 月 27 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(27)日公告 2023 年第三季度自结财务报告。

2023 年第三季度财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 41.65 亿元，较前季增加 6%，较去年同期增加 7%
- ◆ 本季合并毛利率为 22.1%，较前季增加 2 个百分点；
本季营业净利率为 1.7%，较前季增加 6 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 7,000 万元
- ◆ 本季归属于母公司净利为新台币 3,400 万元；
每股盈余为新台币 0.08 元，前季为新台币 -0.23 元

2023 年第四季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第四季营收预计较前一季成长 low-teens 百分比。
- ◆ 第四季毛利率预计约为 mid-twenties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“2023年第三季合并营收为新台币41.65亿元，略优于原先的预期，较前一季成长6%，较去年同期成长7%。由于产能利用率自上一季的40%回升到50%，加上在产品组合方面也略优于之前的预估，营业毛利率自第二季的20.1%上升到22.1%，营业净利率也自上一季的-4.3%回升到1.7%，归属于母公司净利为新台币3,400万元，正式转亏为盈，EPS为新台币0.08元。

综观第三季各项产品的营收变化，除了Optical有优于原先预期的表现，其余的大致吻合我们原先的看法。第三季原本就是高阶智能型手机新机发表的季节，除了Wi-Fi PA的备货高峰已在第二季发生故第三季衰退之外，Cellular PA相关客户的拉货如预期的展开，同时随着中国智能型手机库存逐渐恢复到健康的水位，以及下半年多款新机发表的需求带动之下，中国客户的动能也较第二季进一步放大，因此，Cellular PA营收较上一季有显著成长。

依据研究机构IDC的预测，智能型手机全球出货量年增率继2022年下滑11%之后，今年将持续衰退4.7%，但预估2024年将有4.5%的成长，这样的预估似乎可以从我们下半年的Cellular PA业绩一窥端倪。虽然目前距离过去的季营收高点仍有一段距离，但是已经可以感受到客户需求的逐渐回升，即使过去的需求疲弱使得同业的竞争加剧，稳懋秉持着提供客户最佳的技术、研发及产能资源，当乌云逐渐散去之际客户还是选择与我们站在一起。同时，累积过去多年3D感测的研发及量产实力，我们的光通讯技术已深耕更广泛多元的应用，例如因应AI高速运算带动的数据中心需求及车用光达(LiDAR)市场，持续为未来的长期成长动能做好准备。

展望第四季，我们预期营收将较前一季成长约 low-teens 百分比，毛利率则预期为 mid-twenties 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于1999年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及3D感测领域中，稳懋更以MMIC生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。